

# 2023-2029年中国半导体封 测行业发展态势与未来前景预测报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2023-2029年中国半导体封测行业发展态势与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202306/366154.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国半导体封测行业发展态势与未来前景预测报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

### 第一章 国际半导体产业

#### 1.1 国际半导体产业概况

#### 1.2 IC设计产业

#### 1.3 IC封测产业概况

#### 1.4 中国IC市场

### 第二章 半导体产业格局

#### 2.1 模拟半导体

#### 2.2 MCU

#### 2.3 DRAM内存产业

##### 2.3.1 DRAM内存产业现状

##### 2.3.2 DRAM内存厂家市场占有率

##### 2.3.3 移动DRAM内存厂家市场占有率

#### 2.4 NAND闪存

#### 2.5 复合半导体产业

### 第三章 IC制造产业

#### 3.1 IC制造产能

#### 3.2 晶圆代工

#### 3.3 MEMS代工

#### 3.4 中国晶圆代工产业

#### 3.5 晶圆代工市场

##### 3.5.1 国际手机市场规模

- 3.5.2 手机品牌市场占有率
- 3.5.3 智能手机市场与产业
- 3.5.4 PC市场
- 3.6 IC制造与封测设备市场
- 3.7 半导体材料市场

#### 第四章 封测市场与产业

- 4.1 封测市场规模
- 4.2 封测产业格局
- 4.3 WLCSP市场
- 4.4 TSV封装
- 4.5 半导体测试
  - 4.5.1 Teradyne
  - 4.5.2 Advantest
- 4.6 国际封测厂家排名

#### 第五章 封测厂家研究

- 5.1 日月光
- 5.2 Amkor
- 5.3 硅品精密
- 5.4 星科金朋
- 5.5 力成
- 5.6 超丰
- 5.7 南茂科技
- 5.8 京元电子
- 5.9 Unisem
- 5.10 福懋科技
- 5.11 江苏长电科技
- 5.12 UTAC
- 5.13 菱生精密
- 5.14 南通富士通微电子
- 5.15 华东科技

- 5.16 颀邦科技
- 5.17 J-DEVICES
- 5.18 MPI
- 5.19 STS Semiconductor
- 5.20 Signetics
- 5.21 Hana MiCROn
- 5.22 Nepes
- 5.23 天水华天科技
- 5.24 Shinko

## 部分图表目录

- 图表：2018-2022年国际半导体封装材料厂家收入
- 图表：2018-2022年中国IC市场规模
- 图表：2018-2022年中国IC市场产品分布
- 图表：2018-2022年中国IC市场下游应用分布
- 图表：2018-2022年中国IC市场主要厂家市场占有率
- 图表：2018-2022年模拟半导体主要厂家市场占有率
- 图表：2018-2022年Catalog模拟半导体厂家市场占有率
- 图表：2018-2022年10大模拟半导体厂家排名
- 图表：2018-2022年MCU厂家排名
- 图表：2018-2022年DRAM产业CAPEX
- 图表：2018-2022年国际DRAM晶圆出货量
- 图表：2018-2022年Mobile DRAM市场份额
- 图表：2018-2022年国际12英寸晶圆产能
- 图表：2018-2022年主要Fab支出产品分布
- 图表：2018-2022年国际晶圆加载产能产品分布
- 图表：2018-2022年国际Foundry销售额排名
- 图表：2018-2022年国际MEMS厂家收入排名
- 图表：2018-2022年国际MEMS Foundry排名
- 图表：2018-2022年中国Foundry家销售额
- 图表：2018-2022年国际IC设计公司排名
- 图表：2018-2022年智能手机操作系统市场占有率

图表：2018-2022年国际晶圆设备投入规模  
图表：2018-2022年国际半导体厂家资本支出规模  
图表：2018-2022年国际WLP封装设备开支  
图表：2018-2022年国际Die封装设备开支  
图表：2018-2022年国际自动检测设备开支  
图表：2018-2022年国际半导体材料市场地域分布  
图表：2018-2022年国际半导体后段设备支出地域分布  
图表：2018-2022年OSAT市场规模  
图表：2018-2022年国际IC封装类型出货量分布  
图表：2018-2022年国际OSAT产值地域分布  
图表：2018-2022年台湾封测产业收入  
图表：2018-2022年WLCSP封装市场规模  
图表：2018-2022年WLCSP出货量下游应用分布

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202306/366154.html>